

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-048

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于投资建设高端印制电路板项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为抢抓行业发展机遇，增强核心竞争力，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目的议案》，同意公司全资子公司超毅集团（香港）有限公司（以下简称“香港超毅”）或其子公司投资建设高端印制电路板项目（以下简称“本次投资”），以满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景对高端印制电路板（以下简称“PCB”）的中长期需求。项目投资金额预计不超过10亿美元，主要用于现有产能的提升及新产能的建设。本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

### 二、项目基本情况

1、项目名称：高端印制电路板项目

2、实施主体：超毅集团（香港）有限公司或其子公司

香港超毅隶属于公司超毅事业部（以下简称“Multek”），Multek是印刷电路板技术的领先增值制造商，提供广泛的PCB工程和制造专长，包括高密度互连、刚性、柔性和刚柔结合印刷电路板和装配解决方案。Multek为汽车、互联网、医疗、可穿戴设备、电信、计算机、工业和消费类等行业客户提供产品和服务。

3、投资总额：不超过10亿美元

4、资金来源：公司自有资金或自筹资金

5、项目必要性：

（1）响应市场需求增长。当前高速运算服务器、人工智能等新兴市场的应

用场景正加速渗透且覆盖范围越来越广泛，因此客户对高密度互连、高速信号传输等特性的 PCB 产品需求增加。Multek 现有产能已难以满足客户未来的中长期需求，需通过新增产能快速填补市场缺口，满足客户需求。

(2) 推动产品结构升级。目前 PCB 行业正加速向高附加值产品领域迈进，而普通 PCB 产品竞争加剧。本项目聚焦高端 PCB 领域，可加大高密度互连、刚柔结合等先进技术产品的占比，优化产品结构。

(3) 匹配公司战略布局。本项目作为 Multek 的 PCB 产品升级，与公司布局高端制造能力的战略方向高度契合。通过扩大高端产能，Multek 可进一步巩固其在印刷电路板领域的领先地位。

#### 6、项目可行性分析：

(1) 技术与经验基础。Multek 是印刷电路板技术领先的制造商，拥有丰富的 PCB 工程和制造专长，涵盖高密度互连、刚性、柔性及刚柔结合印刷电路板等领域，具备从早期工程介入、先进技术导入到批量生产的全流程能力，为高端印制电路板的生产提供了坚实的基础。

(2) 客户存在需求支撑。本项目重点面向高速运算服务器、人工智能等新兴场景，此类场景对高端印制电路板存在显著的中长期需求，随着行业的快速发展，将为本项目投产后的产能消化提供潜在的市场支撑，助力公司实现预期效益。

### 三、本次投资对公司的影响

本次投资符合国家高端制造产业政策及印制电路板行业升级的趋势，同时进一步提升公司高端 PCB 的产能，满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景中对高端 PCB 产能的中长期需求。本项目实施将进一步拓展公司经营规模，推动 PCB 产品升级，提升公司整体经济效益。

### 四、本次投资风险分析及应对

1、本项目资金来源于公司自有资金或自筹资金，公司将统筹规划资金安排，确保项目顺利推进。

2、本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评等前置审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件等因素发生变化，或者受宏观经济、行业

政策、市场波动等因素影响，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持沟通，为项目实施配合推进各项审批工作。

3、如未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，有可能存在本项目实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低市场风险。

## 五、其他

1、鉴于本次投资相关工作安排以及公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议本次投资。

2、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年7月25日